



半导体国产化跟踪报告：近期全球半导体产业政策梳理



投资要点

中国在全球半导体产业中仍为“追赶者”姿态。根据美国半导体行业协会（SIA）发布的数据，2021 年全年半导体行业格局（按产值）为美国（46%）、韩国（21%）、日本（9%）、欧洲（9%）、中国台湾（8%）、中国大陆（7%）。近两年来，全球主要国家和地区加大对半导体产业的扶持。随着半导体行业走向成熟以及竞争环节产生剧变，全球半导体产业政策也进入密集区，美国芯片法案、欧洲芯片法案、日本半导体数字产业战略、韩国 k 半导体战略、中国台湾产业创新条例近期陆续落地。

美国（“芯片法案”，2022 年 8 月）：维持技术优势，吸引全球芯片制造龙头在美建厂。从具体政策来看，一是未来五年向半导体行业提供约 527 亿美元的资金支持，并为企业价值 240 亿美元的投资税抵免，鼓励企业在美国研发和制造芯片；二是在未来几年提供约 2000 亿美元的科研经费支持。此外，美国在芯片法案中加入“中国护栏”条款，禁止获得联邦资金的公司在中国大幅增产先进制程芯片，期限 10 年。从政策成效来看，台积电/英特尔/三星已陆续在美建设芯片工厂。

欧洲（“芯片法案”，2022 年 2 月）：加紧先进技术突破，抢占全球市场份额。从具体政策来看，向半导体行业投入超过 430 亿欧元公共和私有资金。其中，110 亿欧元将用于加强现有研究、开发和创新，以确保部署先进的半导体工具以及用于原型设计、测试的试验生产线等。从长期目标来看，在 2030 年将欧洲半导体市场份额从当前的 9%提升至 20%。

日本（“半导体援助法”，2022年3月）：财政预算加码，设备补助提升。从具体政策来看，只要申请企业提出的生产计划符合“持续生产10年以上”、“供需紧绷时能增产应对”等条件，最高将可获得设备费用“半额”的补助金。此外，日本2021财年预算修正案显示，约在半导体行业投入7740亿日元（约合人民币423亿元）。

韩国（“K半导体战略”，2021年5月）：扩大扶持力度，本土企业自强。从具体政策来看，未来十年，包括三星电子和SK海力士在内的153家企业将在本土半导体业务上投入4510亿美元（约510万亿韩元）。这些资金将来自政府支持一揽子计划、税收优惠和企业投资承诺的组合。对研发和设施投资将分别减免40%至50%和10%至20%的税金。在2021年下半年至2024年期间，将对从事半导体等“关键战略技术”的大型企业的资本支出税收优惠从目前的最高3%提高到6%。从长期目标来看，韩国在2030年成为综合半导体强国，主导全球供应链。

中国台湾：（“产业创新条例”，2023年1月）：政策主要集中在税收抵免方面。关键地位企业前瞻创新研发支出的25%可以抵税（优于此前

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_51061

